

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	银河证券：靳学侠；东兴证券：李科融；中原证券：顾敏豪； 东方财富证券：朱晋潇；东北证券：濮阳；上海华邻资产：郭晋； 上海海能投资：王瑞、徐习瑶；四川大决策投资：龚晓豹、罗雅静； 上海弈术投资：孙宏廷；上海远翰基金：刘月茹；上海尚欣投资：宋 明；上海睿沣私募基金：丁颖；北京俊远投资：梁阳平；约调研&投关 易：曹田。
时间	2025 年 7 月 8 日 10:00—11:30
地点	上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛；投资者关系专员：安琪
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书沈一涛详细介绍了公司业务情况，并对胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大业务板块进行了概述。 Q1:2025 年风电行业整体景气度较高，请介绍下公司在风电领域的竞争优势和业绩？ A: 公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售精细化工企业之一。经过三十多年的持续技术沉淀与创新，积累了丰富的胶粘剂产品配方及生产工艺技术，拥有高度自动化的生产线和完善的质量保证体系，品牌效应和市场影响力日益突显，是国内胶粘剂新材料细分领域龙头企业之一。在风电叶片制造领域，作为核心业务的风电叶片结构胶始终保持国内市场份额第一的地位。依托胶粘剂板块的核心竞争力，公司已构建起覆盖风电叶片环氧结构胶、

	风电叶片环氧灌注树脂等核心产品的完整供应体系，成为行业头部企业的重要合作伙伴。 2024 年风电叶片环氧结构胶全年销量突破 4 万吨，风电叶片环氧灌注树脂销量达 4.5 万吨，且连续三年保持稳健增长态势。进入 2025 年，市场优势持续扩大，一季度风电叶片环氧结构胶销售量继续领跑行业。在 "十四五" 规划收官之年，面对风电行业的高速发展机遇，公司将进一步强化核心产品优势，充分发挥规模效应，持续提升市场竞争力，使风电叶片系列产品业务实现高质量增长。 Q2：请介绍一下公司的核心竞争力？ A:公司深耕胶粘剂新材料领域三十余年，通过外延并购完善电子科技板块产业链并向半导体产业方向转型，产品实现进口替代，符合国家支持的产业方向，两大业务板块协同发展态势显著；拥有国家企业技术中心等高端研发平台，近 300 项授权专利及多项标准制定成果，产学研合作助力前沿技术探索；积累优质客户群体，获多项行业荣誉及国际国内体系认证，产品质量获广泛认可；依托国有控股背景及上市公司平台，在战略布局、风险防控、质效提升等方面具备坚实支撑；构建多梯度核心团队，通过双轮驱动机制保障人才供给，支撑组织能力持续升级。 Q3：请介绍一下公司一季度净利润上涨的原因？ A:2025 年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 637.18 万元，相比去年同期增长 125.70%，公司积极推进业务订单生产交付，报告期内营收规模大幅增加，净利润同比扭亏为盈，较上年一季度业绩显著回升。同时，公司胶粘剂新材料板块积极把握市场机遇，产品销量增加，特别是风电叶片系列产品业务发展趋势向好，规模效应逐渐显现；公司各业务板块持续推进降本增效工作，全面提升经营效率。 Q4：请介绍一下公司签署收购意向协议的标的公司？ A:成都中科华微电子有限公司（以下简称“中科华微”）是一家专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，致力于为特种装备领域客户提供优质产品和服务。中科华微立足于核心技术，针对当前和未来市场需求，已形成微控制器芯片（MCU）、通用集成电路、高功率密度电源、系统级封装电路（SiP）四大产品管线，包括微控制器芯片 MCU 和 SOC（32 位微型控制器电路、16 位微控制器电路、8 位微控制器电路等）、系统级 SIP 芯片（射频综合控制 SIP 芯片、数据处理模块、异构处理器 SIP 芯片）、各类模拟集成电路（电源管理、接口电路、信号链电路等）以及电路模块等系列产品，尤其在特种装备 MCU 国产替代细分领域具有技术优势和市场影响力。中科华微被认定为第六批国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，获
--	--

	评四川省瞪羚企业、成都市企业技术中心，相关领域资质齐全。 Q5：请介绍一下意向收购中科华微的目的？ A：公司在“新材料+电子科技”的战略驱动下有序布局，拟通过本次收购实现在半导体集成电路领域的拓展，纳入特种集成电路设计与检测领域的优质资产，形成新的利润增长点，提升公司盈利能力和持续经营能力。 作为国有控股企业，公司将以现有半导体材料产业（包括 CMP 抛光液、溅射靶材、陶瓷材料、电子化学品等）为基础，通过多元化投资模式，加速向半导体集成电路产业战略转型与升级。公司以突破关键领域“卡脖子”问题、填补国内空白为己任，立足“硬科技”，依托前期布局，着力构建涵盖集成电路设计、制造（含 IC、功率半导体 IGBT 芯片及器件等）及封装测试的产业链条。 Q6：请介绍一下公司研发的氧化铝靶材、CMP（氧化铈）抛光液材料？ A:氧化铝靶材可应用于集成电路（IC）制造领域，用于沉积绝缘层和介电层，隔离电路防止干扰，减少电流泄漏，提升产品的可靠性和耐久性。目前控股子公司惟新科技的氧化铝靶材将根据客户订单需求供货。 CMP 抛光液是应用于半导体制造过程中的化学机械抛光（Chemical Mechanical Polishing，简称 CMP）工艺的材料，目前公司正在开展产品的内部测试工作。 Q7：请介绍一下公司控股子公司大连齐化？ A:公司控股子公司大连齐化是以生产销售高品质环氧树脂为主，集特种树脂新材料研发、生产、销售、服务为一体的综合性高新技术企业，目前产品主要分为双酚 A 型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列，包括双酚 A 型液体环氧树脂、双酚 A 型固体环氧树脂、溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂、苯酚酚醛环氧树脂、双酚 F 型环氧树脂、苯氧基树脂、环氧固化剂、环氧稀释剂等多个品种。其生产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可应用于新能源、覆铜板、电子封装、航空航天、轨道交通、涂料及地坪等诸多领域。 经过 20 多年的发展，大连齐化已成长为国内具有一定实力的环氧系统供应商，生产装置所采用的环氧树脂生产工艺是从日本东都化成株式会社引进的技术，属于行业内领先技术之一。大连齐化以其优质的产品质量、持续可靠的稳定性，得到诸多客户的认可，在行业内树立了良好口碑。
--	--

	Q8：请介绍一下公司拟建设泰国胶粘剂新材料生产基地的目的和推进情况？ A:公司在泰国建立胶粘剂新材料生产基地的主要目的是为了能够更好地满足海外客户多方面需求，为海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务的国际化，进一步融入全球产业生态链，建立产品海外供应能力。同时，也有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，提升供应链的韧性和安全水平，最终提升公司市场竞争力和盈利能力。目前该项目正处于前期规划与设计阶段，尚需履行泰国当地投资许可等审批程序。 Q9：请介绍一下公司海外市场的情况？ A:公司在海外市场的业务布局正有序推进，主要依托风电叶片结构胶、风电环氧灌注树脂、无溶剂复膜胶等核心产品的技术优势，逐步拓展国际市场份额。 随着海外业务的拓展，公司在东南亚、中亚、南亚地区均实现了销售，公司未来将结合发展需要，陆续在海外增加设立部分办事处或分支机构，通过贴近客户服务，积极拓展海外市场。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 7 月 8 日